

KODENSHI

光でつなぐコーデシ



空中押しボタン
触れずに操作、
非接触センシング!



小型反射型
エンコーダ



測距センサ

空気、温度、位置等の
環境センシング!



RGBレーザー光源
モジュール



自己気流方式
ほこりセンサ



フラットタイプ
サーモパイル
温度センサ

映像投影、小さな光、大きな世界。
究極のコンパクト光源!

第38回 ネプコン ジャパン
電子部品・材料EXPO
2024.1.24 wed - 1.26 fri
東京ビッグサイト東展示場 23-8



社名：コーデシ株式会社 連絡先：0774-20-3559 住所：〒611-0041 京都府宇治市槇島町十一の161



衝撃に強い 低温はんだ

その問題、低温・鉛フリーはんだの新合金が解消します!
TempSave® B37

組成の改良により耐衝撃性を向上。200℃以下で実装可能です(融点 139 ~ 174℃)

株式会社 日本スペリア社 (TempSave は日本スペリア社の登録商標です)
www.nihonsuperior.co.jp
秋田市江坂町1丁目16番15号 NSビル(本社) ☎06(6380)1121 / (お問合わせ) ☎06(6151)2735

インターネプコンジャパン
出展中 東1ホール E2-20

- 低温はんだは強度が不安
- 基板の反りを抑えたい
- 部品の熱負荷を減らしたい
- 実装電力を削減したい
- 資材コストを下げたい

ネプコン ジャパン

あす開幕 東京ビッグサイト



エレクトロニクス分野の多様化や高性能化を支える製品や技術が紹介される (第37回ネプコンジャパン)

多様化・高性能化 電子機器を支える最新技術

「ネプコン ジャパン」展「エレクトロニクス EXPO」はエレクトロニクス分野の製造や実装、電子部品・材料、E 生産・実装に携わる企業・技術者への展示場として、同展はテーマを絞り「EXPO」を「プリント」に絞り、電子機器の多機能化・高性能化を支える最新技術を紹介する。会場は個別テーマに、ハンダや洗浄剤、細かな電子部品を印刷、多層化するプリント配線基板に実装する「マウンター」、実装技術など、モジュールに関する材料やリフロー炉の要求に合わせた。フロッピーハンダ付け装置、プリント配線板に実装する「はんだ」、エレ実装部品(サーフェスマウント)の製造、マウント・デバイス生産・実装などにおける「SMD」やチップ部品の受託サービスなど、コネクタMS/製造受託など、抗器、インダクター、抵

電子部品・半導体 微細化を実現—実装技術

密度の向上や電子部品の微細化、狭ピッチ化を背景とする信頼性の高い実装では、酸化防止剤(フラックス)の残留の洗浄が求められている。洗浄剤はVOC(揮発性有機化合物)削減に配慮している。自動車はEV、HV、HEV化に加えて、電子部品の搭載数を拡大させている。電子部品は、高密度で、高信頼性、耐振動性に耐えなければならない。SMC(表面実装コンポーネント)は、温度変化が激しい環境でもハンダ内のボイド(空洞)が生じないよう、信頼性を支えている。検査機、計測器、マウンター、ハンダ材料は、微粉末、ほぼ表面積と酸化量が、増える。そのため活性化しやすく、リフロー炉での酸化を抑制するフラックスが重要になる。超微細化した電子部品をハンダ付けするために、ハンダ材料、実装するマウンターは、モバイル機器などの速度や安定性に加え、薄い基板では熱による実装時の不良率や装置、主にSnBi(スズ・鉛)系合金、組成の低鉛鉛フリーハンダ化を目指している。組立ハンダ材料は、組立ハンダ材料は、組成改良により無鉛で200℃以下の低温実装でき、耐衝撃性に優れる。低温でハンダ付けできるため、電気使用量を抑え、エネルギーと酸化炭素(CO₂)排出を抑制でき

電子機器の多様化や高性能化、電気自動車(EV)・ハイブリッド車(HV、HEV)などを支える電子部品・材料や製造・実装・検査装置が集結する「第38回ネプコン ジャパン」エレクトロニクス開発・実装展」が24日から26日までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイト東展示棟1-4、6ホールで開催される。主催はRX Japan。開場時間は10時から17時まで。入場には事前登録(無料)が必要で、同展ホームページから入手できる。東4-8ホールでは「オートモーティブワールド」、西展示棟では「Factory Innovation Week」「スマート物流EXPO」「ウェアラブルEXPO」を同時開催する。全体で約1050社・団体が出展し、3日間で約8万5000人の来場を見込んでいる。



FUJI
innovative spirit

FUJI Smart Factory Platform
NXTR

ARE YOU READY?

Debut!

拡張型オールインワン装着機
AIMEXR

第38回 インターネプコン ジャパン
エレクトロニクス製造・実装展
FUJIブース 東1ホール E1-2






インターネプコン 2024
FUJI特設サイト

プリント基板のフラックス洗浄

New マイクロクリーナー



未来材料に挑戦する
化研テック
https://www.kaken-tech.co.jp



非危険物



VOC
排出削減



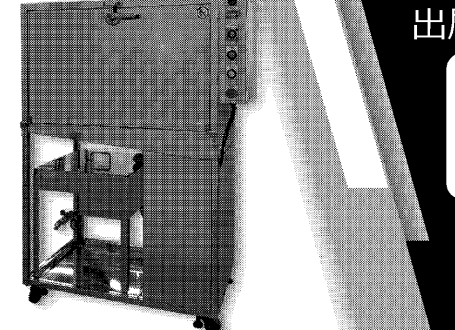
狭ギャップ
洗浄


マイクロクリーナーの
詳細はこちら！




Dipパレットの洗浄

パレットクリーナー






作業時間
短縮




コスト
削減



高
洗浄力

インターネットジャパン
に出展いたします。

出展製品情報



ブースNo.
東1ホール1-8

インターネットジャパン

出展企業の製品・技術 展不同

日本スベリア社

日本スベリア社の鉛フリーハンダ「TempSave」シリーズは、資材コスト削減と二酸化炭素(CO2)排出量の削減に貢献している。国内の大手家電メーカーの量産品に採用された「TempSave B58」は、ビスマス58%、スズ42%の合金で、フローハンダ付けが可能。特に銀の含有をゼロにしたことで大幅なコスト削減を実現した。融点139度Cで低温接合でき、実装工程の消費電力を約3割削減できる。

中国(江蘇省南運市)とマレーシアの新工場が2023年に稼働。現地ニーズと生産需要に対応している。中国内では5拠点目となり、現地体制をさらに強化。マレーシアでは、二つ目の工場として研究開発(R&D)施設を併設している。

FUJII

FUJIIは電子部品実装機(チップマウンタ)の新製品「AIMEXR(エイメックスアール)」を展示する。同機はAIMEXシリーズのハイエンドモデルで、多品種生産の生産性向上に必要となる汎用性を極限まで高めた、フレキシブルなオールインワン実装機。軽量化と高速化を実現したXマロボットと最新ヘッドを組み合わせたことで、生産速度の向上と高精度を両立した。基板の反りや部品の状態を検知し、電子部品と基板へのストレスを最小限にして装着する。

またNXTシリーズのハイエンドモデル「NXTR」も出品。次世代の実装ソリューション、自動化ソリューションを紹介する。

タムラ製作所

タムラ製作所は高信頼性ソルダーペースト「LF2007」シリーズ、アルカリ現像タイプ液状ソルダーレジスト「DSRR-2220OACR」、リフロー装置「TNV Version III」を出品する。ソルダーペースト、ソルダーレジストは、340度Cで15分5度Cの3000サイクル試験後のハンダ接合部やソルダーレジストのクラック発生を抑制。HV、EV化に伴う自動車の電子制御ユニット(ECU)の機電一体化に必要な厳しいヒートサイクル基準に対応する。リフロー装置は高速取り替え、予防知機能など新たな技術を紹介する。材料と装置から、持続可能なエレクトロニクス産業の成長を支えている。

荒川化学工業

荒川化学工業はロジックケミストリー、機能性ポリマー設計をベースとしたコア技術と素材をもとに、電子部品・デバイスなどエレクトロニクス産業に欠かせない多様な素材に新たな機能と付加価値を提供する。

第5世代通信(5G)/6Gへの応用が可能な「低誘電率リジッド樹脂PIAD」や「低誘電率接着剤」フラスチック用添加剤「PLAFIT」に加え、同社が強みとする水溶性ポリマー合成技術を活用して開発した「リチウムイオン電池用水系バインダー樹脂(正極・負極・セパレーター用)」、微小電気機械システム(MEMS)用中空封止樹脂「半導体部材に貢献できる「感光性ポリイミド」」を展示する。

ジャパンユニックス

ジャパンユニックスは生産性と品質を追求した新型レーザーハンダ付けシステム「デュアルエリアレーザー」の実験を予定している。レーザーを上下から照射することで、従来の治具や基板の反転が不要になり、生産工程の省スペース化を実現する。放射温度計を併用し技術検証を重ねて、量産工法を確立した。工程管理ソフトで、ハンダ付けの工程中の計測数値と動画データを保存し、不良解析などにも活用できる。

展示会では、ハンダ付けの自動化を要請する来場者に向けて、同社製品の特長から技術、導入後のサポートまで紹介するエリアを設け、「ハンダ付け自動化のパートナー」としての存在感を提案する。

化研テック

化研テックはフラックス洗浄剤「マイクロクリーナーECO&マークレスECO」を出品する。水を約70%含有する消防法の非危険物タイプで、従来の洗浄剤と同じ洗浄力を保持し揮発や乾燥による揮発性有機化合物(VOC)の総排出量を約50%低減できる。蒸留再生器を内蔵したコンパクトな洗浄装置で使用するため、廃液の発生を従来比で約85%削減する。

またインプロパノール(IPA)を用いた洗浄の事例が多いハンダパレットの洗浄に向け、最大15枚のハンダパレットを一度に洗浄できる「シャワー式洗浄システム「パレットクリーナーPCIT」と、専用洗浄剤「パレットシリーズ」も紹介する。

エレクトロニクス-製造・実装・検査の最前線

ネコンジャパン 7構成展

半導体・センサパッケージング展

「第25回 半導体・信頼性 低コストなどセンサパッケージング」求められる要件が異なる「展(ESP)」は、これらには2・x2・5次元(2・5Dや3D)、再配線層D)や3D実装、チップ(DRL)、シリコンパレットなど技術革新 貫通電極(TSV)、が進む半導体後工程に チップレット、新たな特化した専門展。設計手法、シミュレーション環境などの掛け合わせが必要となる。こうした中、展示会では半導体やセンサ、低消費電力、高信 では半導体やセンサ

「第1回」パワーデバイスとモジュール EXPO」は、省エネ エネルギー、鉄道、産業用機器などに携わる来場者に、パワーモジュールの専門 ール製品や技術を訴求 展、関連する部品・材 する。

エレクトロテスト ジャパン

「第38回 展示される。エレクトロテスト ジャパン」を展示している。設計や開発者との試作受発注、開発相談などの商談、技術相談が行える。

「第25回」発受託、設計ツールな配線板 EXPO」を対象とした展示会「WB」はプリント配線板・材料、設計、開

電子部品・材料 EXPO

「第25回 電子部品・材料 EXPO」はエレクトロニクス製品の高機能化、軽薄短小化を支えるさまざまな電子部品と電子材料に加え、技術手法、TSVなどの接合対応薬品などが紹介される。第5世代通信(5G)向けの部品と材料のゾーンを用意している。

半田ボール搭載の全く新しい発想!

はんだボール搭載機 ソルダバウンサー(SOLDER BOUNCER)

半田ボールが跳ねる、くつつく!



詳しくは弊社ホームページをご確認ください!

ネコンジャパン2024 E33-8

Micro-tec 株式会社
本社:〒297-0012 千葉県浦安市人船1-5-2 プライムタワー新浦安13F
TEL: 047-350-5131(代) FAX: 047-350-5133

Energize the Future 100

タムラ製作所はインターネットジャパン・パワーデバイス&モジュールEXPOに出展いたします

会期: 2024年1月24日(水)~26日(金)
会場: 東京ビッグサイト

インターネットジャパン
エレクトロニクス製造・実装展

小間番号 E3-8

パワーデバイス&モジュールEXPO
小間番号 E35-19

TAMURA 株式会社タムラ製作所 https://www.tamura-ss.co.jp/

Web Linked In



つなぐを化学する



マツタロウ ロジーナ

インターネットジャパン
エレクトロニクス製造・実装展

会期 1/24(水)-26(金)
会場 東京ビッグサイト

ブース番号 E8-33

- プラスチック用添加剤「PLAFIT」E、HJシリーズ
- 低誘電率リジッド樹脂「PIAD」
- リチウムイオン電池向け水溶性バインダー
- 低誘電性粘着剤
- 感光性ポリイミド組成物「PR-P1」

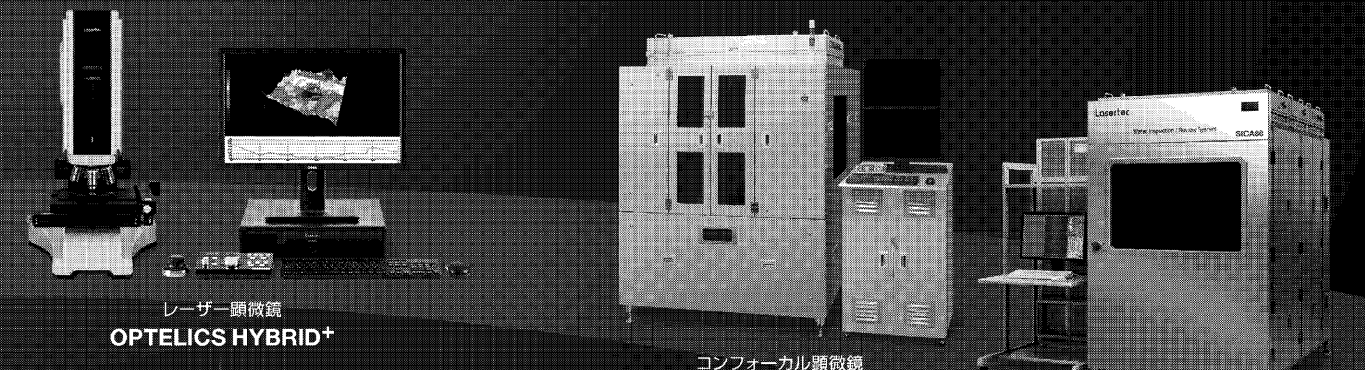
ARAKAWA CHEMICAL 荒川化学工業株式会社



Lasertec

Confocal System Solution

開発・量産フェーズに最適な装置提案



- R&D
- 抜き取り検査
- 異形サンプル対応
- 量産Fab対応
- 全数検査
- 自動搬送・検査

R&D用途から抜き取り検査、さらに量産Fabでの全数検査に至るまで各検査・測定ニーズに合わせた最適な装置のご提案が可能です。

レーザーテック株式会社
www.lasertec.co.jp



エレクトロテスト ジャパン
2024年1月24日(水)~26日(金)
東京ビッグサイト・小間番号 E17-13 (東展示棟)

ネプコン ジャパン
エレクトロニクス開発・実装展
ブース番号E35-28

先進、挑戦

ものづくりの課題に挑む。

高品質で持続可能なものづくりに貢献するために。JCUは、世界に誇る表面処理技術と研究開発力で加速する時代に挑み続けます。



JCU 株式会社JCU

ネプコン ジャパン

あす開幕
東京ビッグサイト

エレクトロテスト ジャパン

レーザーテックは光源に白色光とレーザー光を搭載したコンフォーカル顕微鏡「OPTELICS HYBRID+」とコンフォーカル顕微鏡自動検査/レビュー装置「OPTELICS AI2」を出展する。

レーザーテック

シリコン(Si)ウエハーや、微小電気機械システム(MEMS)といった電子部品、精密部品の検査、形状測定だけでなく、化合物半導体やフィルム、ガラス基板などの透明材料においても裏面反射の影響を受けずに高倍率レビュー、形状測定ができる。

パワーデバイス&モジュール EXPO

マイクロ・テック
マクロ・テックはスクリーン版を使用した印刷法であるスクリーン印刷機をはじめとする、各種電子部品製造設備を提供している。展示会ではスクリーン印刷機に新オプションとして振動技術を採用した「Vibrator」、新しい発想を取り入れたハンダボール搭載機「Solder Bouncer」、極超高精度LED乾燥装置「META-FLASH」などを紹介する。

半導体・センサ パッケージング展

奥野製薬工業
奥野製薬工業は「プリント基板/半導体パッケージ」の発展に貢献するOKUNOの製品をテーマに、配線の微細化とマイクロピアの小さく化の課題を解決する無電解めっき技術「OPC-FL ETPプロセス」や、フライングパターン対応の無電解ニッケル/金めっき技術、パワーマニキュール向け絶縁回路基板用無電解めっき技術を紹介する。

電子部品・材料 EXPO

コーデンシ
コーデンシは研究開発型企業として京都府宇治市で創業。設立以来、創造的進化で限らない発展に努め、光半導体技術を中心に、測距センサーやフォトインタラクター、回転を検知する光学式エンコーダーなど多種多様な製品を開発している。

JCU
JCUは強みである配線形成に必要な銅めっき、エッチング薬品を中心にモテイブアイトセミアイブ工法(MSAP)、セミアイブ工法(MSAP)など最適なプロセスを提案。2023年11月に立ち上げた半導体向けのブランド「TIPHERES(ティファレス)」シリーズも紹介する。



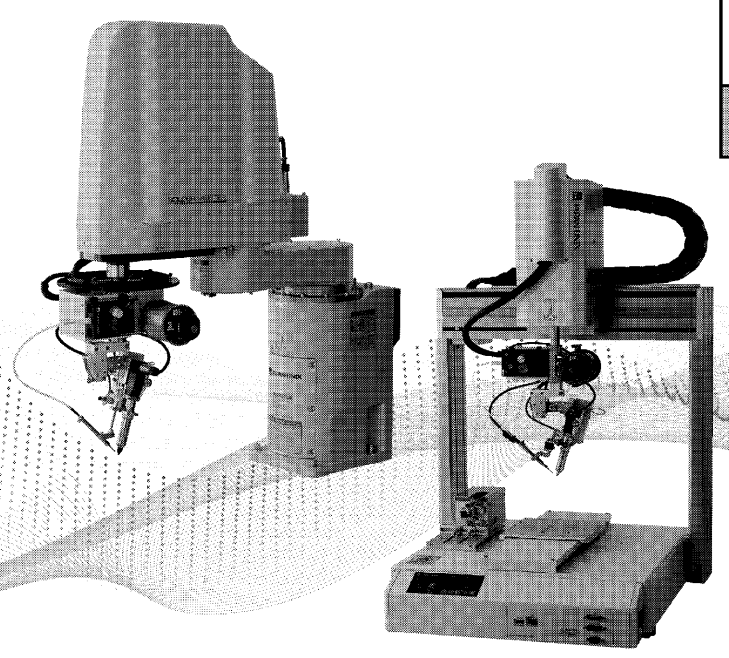
エレクトロテスト ジャパンでは検査・試験装置が紹介される。(第37回ネプコン ジャパン)

JAPAN UNIX

第38回 ネプコン ジャパン
エレクトロニクス開発・実装展
2024年1月24日(水)~26日(金) 出展します!

はんだ付自動化のエキスパート集団

製品、技術、サポート体制...
ジャパンユニックスはどんなことが出来るのか?
改めて基礎からご説明します!



IPCセミナー情報	IPC標準規格
<p>はんだ付の国際認証資格 CISはんだ付け トレーニング</p> <p>J-STD-001:187,000円~275,000円(税込) IPC-7711/21:231,000円~363,000円(税込) お問い合わせ tel.03-3588-0551 (IPC担当)</p>	<p>世界の製造業が採用 品質標準のグローバルスタンダード</p> <p>・電子組立品の許容基準 [IPC-A-610JP] ・プリント板の受け入れ [IPC-A-600JP] お問い合わせ tel.03-3588-0551 (IPC担当) オンライントレーニング https://training.ipcstore.jp</p>

「相談から量産まで」はんだ付自動化をサポートします

株式会社 ジャパンユニックス http://www.japanunix.com
本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-21-25 Tel. 03-3588-0551 Fax. 03-3588-0554
大阪営業所 Tel. 06-6190-4580 Fax. 06-6190-4581 名古屋営業所 Tel. 052-679-2111 Fax. 052-679-2112 熊本テクノセンター Tel. 096-287-4501 Fax. 096-287-4503

第25回 半導体・センサ パッケージング展

出展のご案内
半導体後工程の専門展 ISP
会期: 2024.1.24(水)~26(金) 会場: 東京ビッグサイト 東4ホール[33-38]



オクノのエレクトロニクス向け最新技術
奥野製薬工業は、半導体後工程向けの表面処理・めっき薬品として、TORYZAシリーズをリリースしました。薬品だけでなく、装置に関してもあらゆるご要望にお応えします。さらに、半導体パッケージ基板向けの最適なめっき添加剤を拡充。2025年には新工場も完成、高品質な供給体制を強化します。オクノは、半導体産業の発展を支える表面処理・めっき薬品のリーディングカンパニーです。

TOP 奥野製薬工業株式会社 www.okuno.co.jp